



สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยสูปได้รับ การทำผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำด้วยวิธีการระเหยไอโลหะในสภาวะสูญญากาศ จะเกิดขึ้น interfacial layer ขึ้น ขณะทำการฉาบไอโลหะอย่างหลักเสียงไม่ได้ interfacial layer ที่เกิดขึ้นจะทำให้ผิวสัมผัสมีลักษณะสมบูรณ์ เลวลงกล่าวก็อผิวสัมผัสแบบเรคติฟายอิงต่างไปจากอุดมคติ คือ กระแสไฟฟ้าในชั้นข้อนี้เป็นกระแสตรงเดินไปหัว และกระแสไฟฟ้าในชั้นเดินไปหัวตามมีค่าต่ำลง และผิวสัมผัสแบบไอโอมีค่าความต้านทานสูง

การอบความร้อนเป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อลอกอิทธิพลของ interfacial layer และทำให้โลหะยึดเกาะกับแวร์ฟลิกแน่นขึ้น เมื่อพิจารณาในแต่ละกระบวนการอบความร้อน อุณหภูมิเนียมเป็นโลหะที่เหมาะสมที่สุดในการทำผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับแวร์ฟลิกชิลิกอน เมื่อจากอุณหภูมิเนียมแรร์ชีมเข้าไปในแวร์ฟลิกอนได้น้อยและ eutectic temperature มีค่าต่ำพอสมควร นอกจากนั้นอุณหภูมิเนียมยังทำได้ง่าย ราคาถูก และได้มีการศึกษาใช้งานมาเป็นเวลานาน

เงื่อนไขในการอบความร้อนผิวสัมผัสระหว่างอุณหภูมิเนียมกับแวร์ฟลิกชิลิกอนที่เหมาะสมคือ อบความร้อนที่อุณหภูมิ 550° - 600° เชลเซียส นาน 20 นาที

การทำผิวสัมผัสด้วยวิธี electroless plating เป็นวิธีที่ง่ายและราคาถูกที่สุด ผลปรากฏว่าแรงยึดเกาะระหว่างนิเกิลกับแวร์ฟลิกชิลิกอนไม่แน่นพอ อย่างไรก็ได้วิธี electroless plating เหมาะสมที่จะใช้ในการเคลือบมิเกิลบนขั้วต่ออุณหภูมิเนียมหลังจากทำผิวสัมผัสระหว่างอุณหภูมิเนียมกับแวร์ฟลิกชิลิกอนแล้ว เพื่อเยื่อมต่อขั้วต่อ กับสายต่อตัวต่อ วิธีการนี้เหมาะสมในกระบวนการทำเชลแลง อาทิตย์ เมื่อจากการเชื่อมขั้วต่ออุณหภูมิเนียมด้วยตะเก็บโดยตรงทำไม่ได้

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำได้กันมาใช้โลหะผสมระหว่างอุณหภูมิเนียมกับชิลิกอนแทนอุณหภูมิเนียมบริสุทธิ์ เมื่อจากผิวสัมผัสที่ทำจากโลหะผสมดังกล่าวมีการแรร์ชีมของอุณหภูมิเนียมเข้าไปในแวร์ฟลิกชิลิกอนน้อยกว่าผิวสัมผัสที่ทำจากอุณหภูมิเนียมบริสุทธิ์มาก (74) ในการทำสิ่งประดิษฐ์

สารกึ่งตัวนำที่ต้องระมัดระวังการแพะซึมของโลหะเข้าไปในแวนพลัคชิลิกอน เช่น เขลแสงอาทิตย์ ซึ่งความลึกของหัวต่อตื้นมากอาจ ควรเลือกใช้โลหะผสมดังกล่าว

การทดสอบค่า contact resistivity ρ_c ของผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับแวนพลัคชิลิกอน ด้วยวิธี TLM อาจทำได้ โดยเพิ่มค่า contact resistance ให้มากกว่าความต้านทานระหว่างขั้วต่อโลหะกับหลักต่อสายด้วยการลดขนาดฟันที่ของขั้วต่อโลหะให้น้อยลง แต่การทำ mask และการต่อสายจะลำบากขึ้น